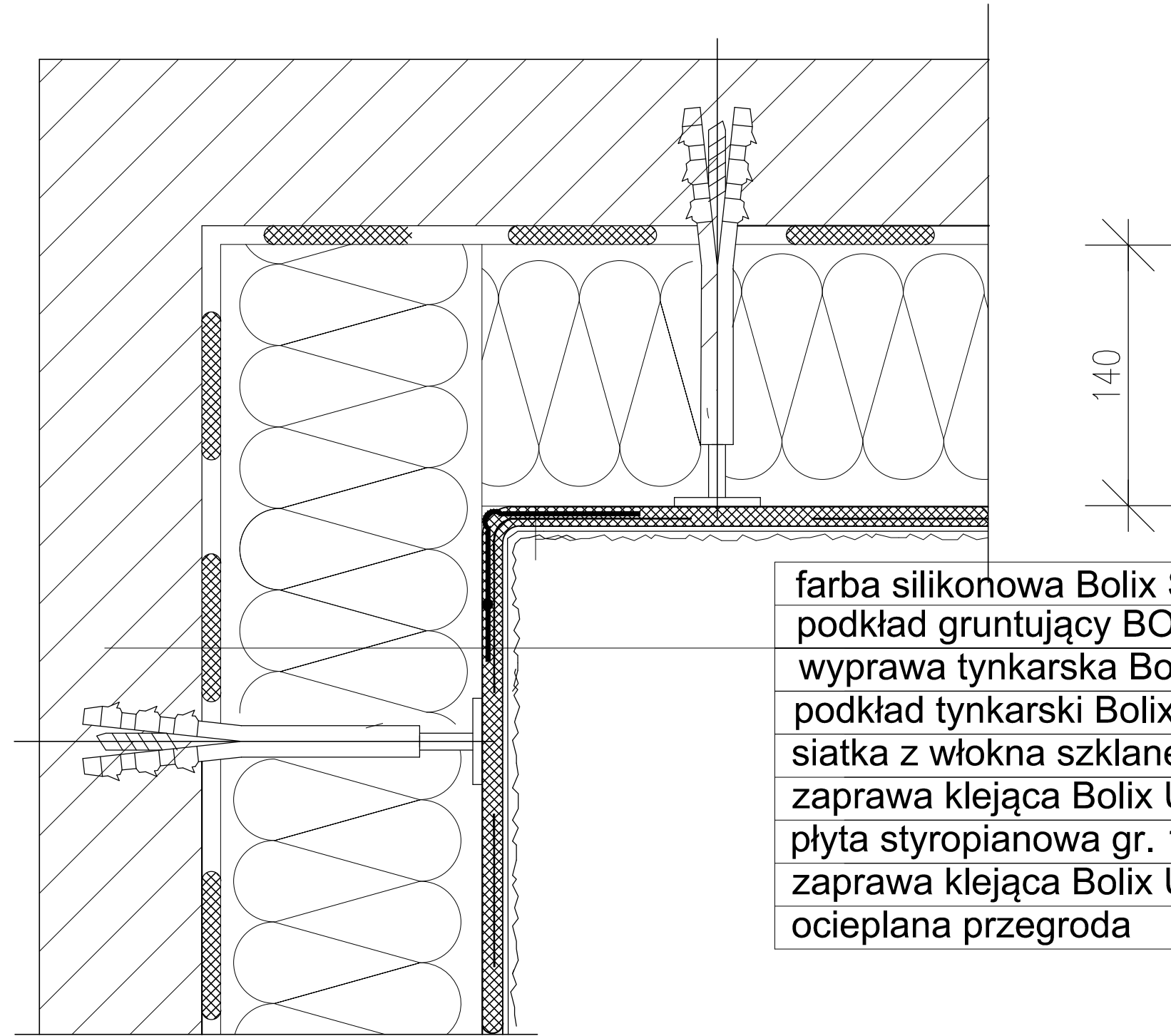
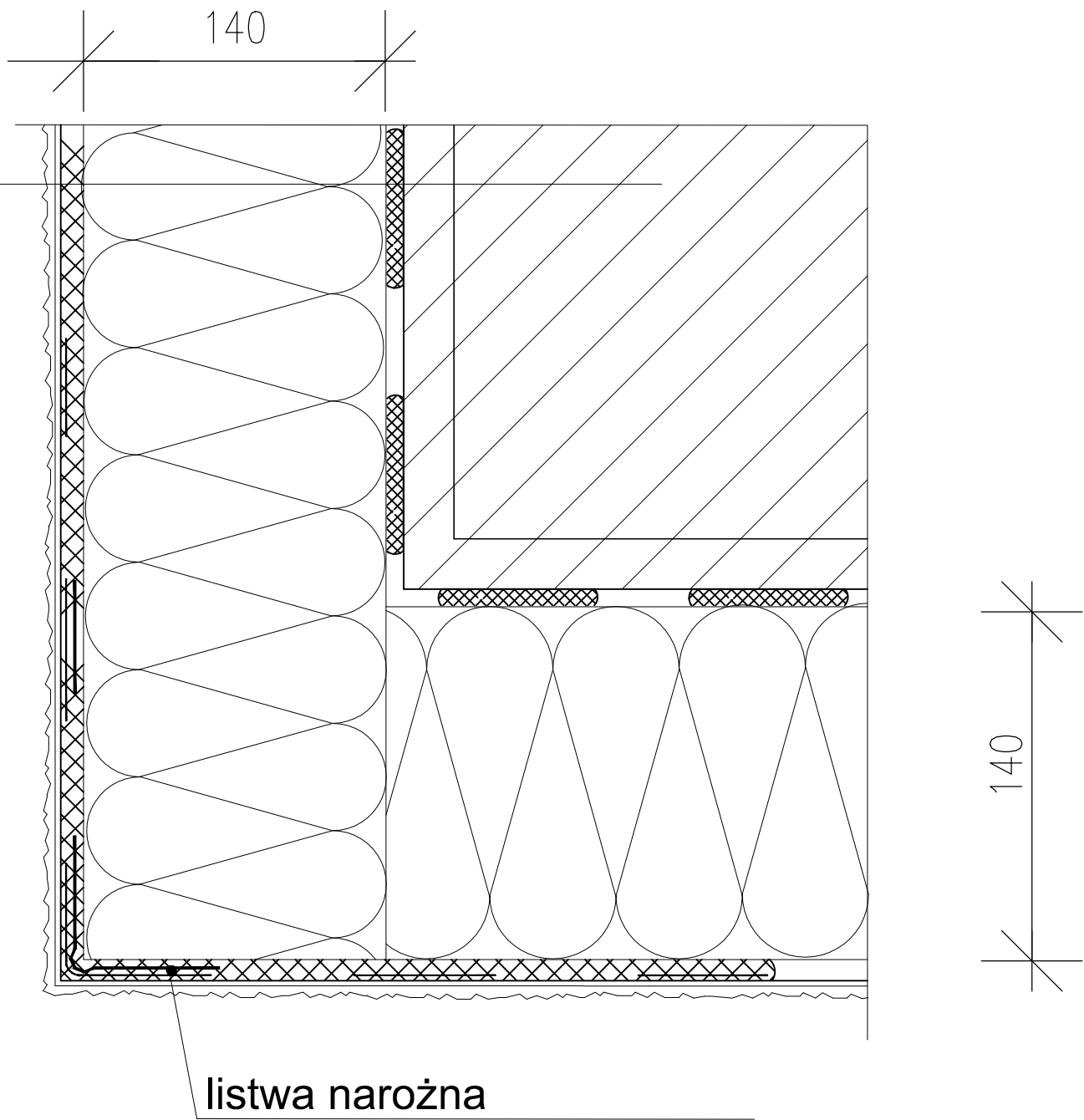




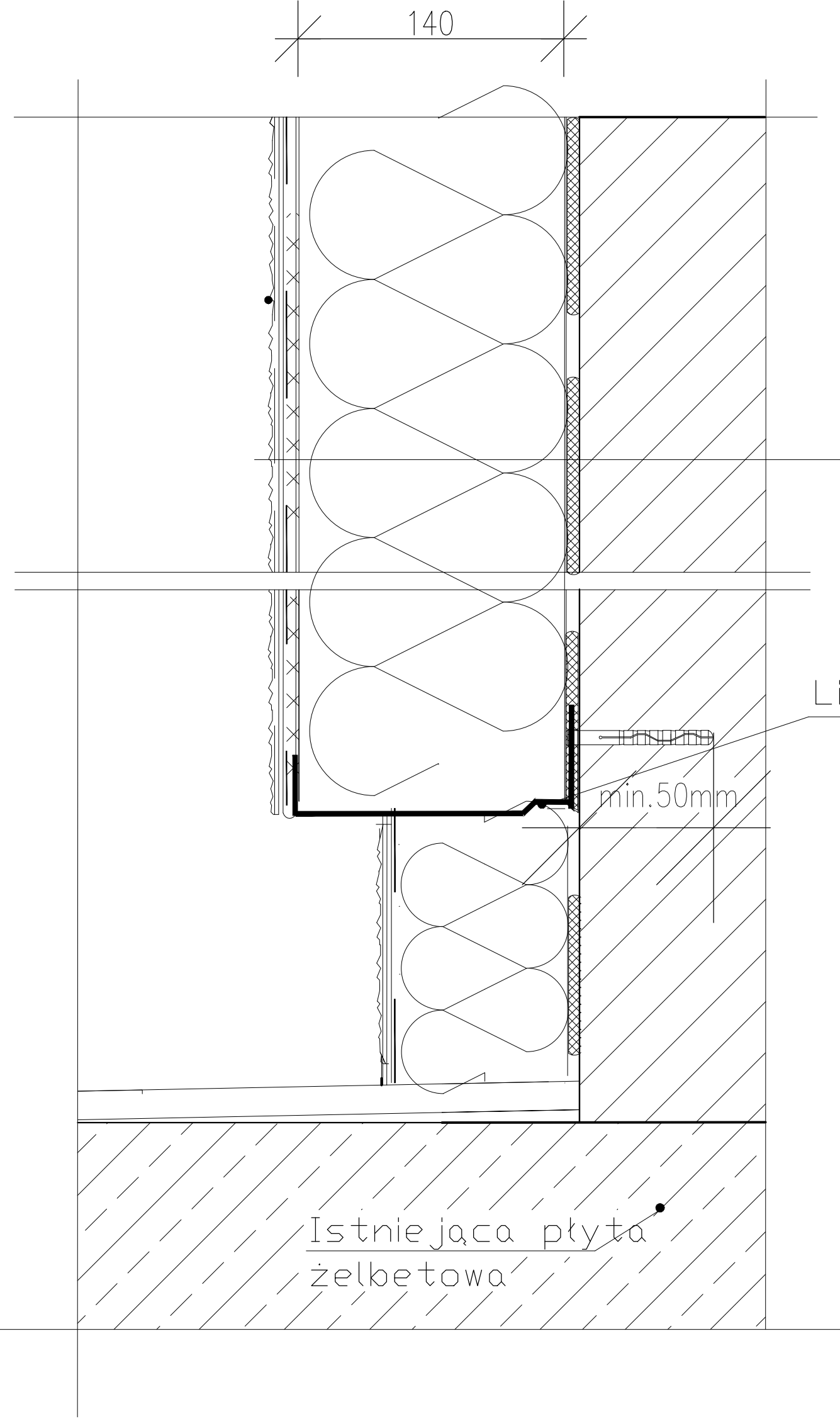
farba silikonowa Bolix SIL
podkład gruntujący BOLIX SIG
wyprawa tynkarska Bolix MP KA 20
podkład tynkarski Bolix OP
siatka z włókna szklanego
zaprawa klejąca Bolix U
plyta styropianowa gr. 14cm λ 40
zaprawa klejąca Bolix U
ocieplana przegroda

Rys. B-4. Detal styropianem ocieplenia naroża wklęsłego

farba silikonowa Bolix SIL
podkład gruntujący BOLIX SIG
wyprawa tynkarska Bolix MP KA 20
podkład tynkarski Bolix OP
siatka z włókna szklanego
zaprawa klejąca Bolix U
plyta styropianowa gr. 14cm λ 40
zaprawa klejąca Bolix U
ocieplana przegroda



farba silikonowa Bolix SIL
podkład gruntujący BOLIX SIG
wyprawa tynkarska Bolix MP KA 20
podkład tynkarski Bolix OP
siatka z włókna szklanego
zaprawa klejąca Bolix U
plyta styropianowa gr. 14cm λ 40
zaprawa klejąca Bolix U
ocieplana przegroda



Listwa startowa

Rys. B-7. Detal połączenia ocieplanej ściany z płytą dachu

farba silikonowa Bolix SIL
podkład gruntujący BOLIX SIG
wyprawa tynkarska Bolix MP KA 20
podkład tynkarski Bolix OP
siatka z włókna szklanego
zaprawa klejąca Bolix U
plyta styropianowa gr. 14cm λ 40
zaprawa klejąca Bolix U
ocieplana przegroda

listwa okapnikowa

uszczelniająca samoprzylepna taśma rozprężna

dekoracyjny tynk mozaikowy BOLIX TM
podkład tynkarski BOLIX OP
podwójna siatka z włókna szklanego w kleju BOLIX U
plyta styropianowa fundamentowa gr. 11cm λ 35
klej do styropianu BOLIX U
ocieplana przegroda

Rys. B-6. Detal ocieplenia cokołu

Nazwa inwestycji Projekt budowlany docieplenia budynku nr 6 na terenie BUMAR ELEKTRONIKA S.A., 04-051 Warszawa przy ul. Poligonowej 30		
Inwestor BUMAR ELEKTRONIKA S.A. 04-051 Warszawa, ul. Poligonowa 30		
Generalny Projektant STUDIO BUDOWLANE "UNITY" S.C. ul. Kędzierskiego 2/66, Warszawa		
Projektant	mgr inż. Leszek Tischner	nr ewid. 157/2002
Sprawdzający	mgr inż. Damian Cyrta	MAZ/0003/POOK/09
Asystent	mgr inż. Sebastian Galiński	
Asystent	inż. Radosław Lenart	
Tytuł rysunku: Detale B-4, B-5, B-6, B-7		
Data: maj 2014 r.	Skala 1:5	Rys. nr: 8